

2024年 8月 20日

委員各位殿

一般社団法人 溶接学会
マイクロ接合研究委員会
委員長 福本信次
(公印省略)

マイクロ接合研究委員会 開催通知

第147回マイクロ接合研究委員会を下記の通り開催致しますので、万障お繰り合せの上
ご出席下さいますようお願い申し上げます。

出欠は9月6日(金)までにお知らせ下さい

記

- 日時 2024年(令和6年) 9月 13日(金) 10:30~16:15
- 場所 大阪大学 医学・工学研究科 東京ブランチ 913会議室
東京都中央区日本橋本町二丁目3番11号 日本橋ライフサイエンスビルディング9階
- 幹事会のご案内
幹事会を12:00~開催いたしますので、幹事または代理の方はご出席下さいますようお願い申し上げます。会場は911会議室です。

【出欠・事務関連の連絡先】

一般社団法人溶接学会 事務局 木暮
E-mail: s_kogure@tt.rim.or.jp TEL: 03-5825-4073

第147回マイクロ接合研究委員会
プログラム

日 時： 2024年 9月 13日(金) 10:30～16:15

場 所： 大阪大学 医学・工学研究科 東京ランチ 913 会議室(東京 日本橋)

時 間	題 目	講 演 者
司 会 小野木 剛 (タムラ製作所)		
10:30～11:15	『ギ酸塩被膜処理を施した Sn-Zn はんだシートのフラックス接合の検討』 (資料番号MJ-864-2024)	群馬大学大学院 ○山崎浩次、井上岳斗、小山真司
11:15～12:00	『深層学習を利用した BGA における はんだクラック進展三次元解析』 (資料番号MJ-865-2024)	(株)クオルテック ○長谷川将司、鬼塚梨里、 緒方森、植木竜佑、高橋政典
12:00～13:00	昼 食 休 憩	
13:00～13:10	委 員 会 議 事	
司 会 朝倉 義裕 (神戸高専)		
13:10～13:55	『ナノポーラス Cu めっき構造を用いた直接接合技術の提案』 (資料番号MJ-866-2024)	三菱マテリアル(株) ○中川卓真、古山大貴、 片瀬琢磨、中川将
13:55～14:40	『低荷重接合を実現する先鋭 Cu マイクロバンプ接合技術』 (資料番号MJ-867-2024)	パナソニック ホールディングス(株) ○五十井浩平、糸井清一、 櫻井大輔
14:40～15:00	休 憩	
司 会 宇野 智裕 (日本製鉄)		
15:00～15:45	『摩擦攪拌接合におけるプロセス可視化』 (資料番号MJ-868-2024)	豊橋技術科学大学 ○安井利明
15:45～16:15	『各種接合装置と接合事例』 (資料番号MJ-869-2024)	アユミ工業(株) ○小田知弘

※プログラムは都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

4. 配付資料について

当日の配布資料は委員会開催前にダウンロードシステムを利用し皆様へご送付致します。
開催当日までにご自身にて印刷を行っていただきご準備のうえご参加をお願いいたします。

✓配付資料は各自でご持参ください。会場に紙資料のご用意はございません。

(案内図)



アクセス

- ・東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅A6出口より徒歩3分
- ・J R総武本線「新日本橋」駅 5番出口より徒歩2分
- ・J R各線「神田」駅 南口より徒歩 11分
- ・J R各線「東京」駅 新日本橋口より徒歩 17分